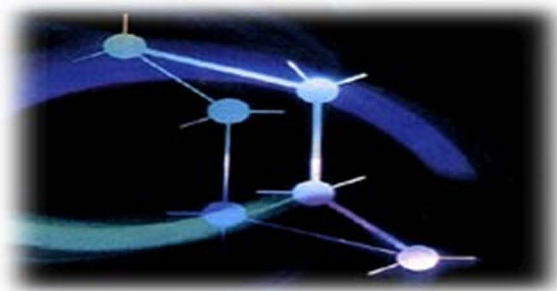


韩国元化学  
(주)원케미컬

 **Won Chemical .co.Ltd**

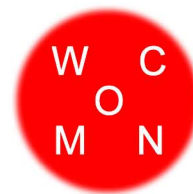


中国地区总代理



深圳市力邦泰科技有限公司  
南山区南山大道深意工业大厦516

Tel : 86-755-88864001  
[www.NewBonder.com](http://www.NewBonder.com)





韩国元化学株式会社主要从事开发和生产电器电子产业中广泛使用的环氧树脂 (Epoxy) 绝缘 Mold 材料, 黏合剂以及Epoxy Modified Uv 硬化型树脂。我们以绝缘材料领域积累的经验和技术为基础, 积极应对电器电子行业的高功能化发展趋势引起的技术变化。同时我们对我们的核心产品不断进行质量改善和提高, 改变本行业以前全部依靠进口的局面。我们在开发研制 SMD 黏合剂、BGA/CSP用底部填充环氧树脂 (underfill resin)、清洁化合物 (Clear Compound) 和 Cob树脂等方面倾注精力。今后我们将以我们产品的质量和价格竞争力, 成为电器电子产业的发展的主力, 不断进行开发研制, 使我们成为最有竞争力企业。

저희주식회사원케미컬은전기, 전자산업에널리사용되고있는Epoxy절연Mold재, 점착제및Epoxy Modified Uv경화형수지등을개발, 생산하고있습니다.그동안절연재로분야에서의경험과Know-How를바탕으로고기능화로급속히변화하는전기, 전자시장의상황에요구되는기술변화에신속하게대응하고자노력하고있습니다.또한당사는기존제품에 대한지속적인품질개선은물론,그외수입에의존하고있는화학제품에대한국산화에노력하고있습니다.그결과SMD점착제,BGA/CSP용Underfill수지,Clear Compound및Cob용수지등의국산화개발에주력하고있습니다.향후에도당사에서는품질과가격경쟁력을바탕으로전기, 전자산업의발전에일익을담당하고자지속적인연구개발로보다경쟁력있는업체로발돋움할것을약속드리며여러분의많은지도편달있으시길기원합니다.감사합니다.

### 主要产品系列

Underfill底填胶	Underfill Resin For BGA &CSP&FP
低温固化粘接胶	Low Curing Adhesive For CMOS
OCR光学透明胶	Optical Clear Resin For Touch Panel
玻璃薄化密封胶	Sealant For TFT-LCD Panel Sliming
电子装配补强胶	Corner Bonding For SMD&Earphone
LED芯片封装胶	Encapsulant For High Brightness LED

本土典型客户：



SEOUL SEMICONDUCTOR



## 韩国元化学底部填充胶水(Underfill Resin)

底部填充胶水是一种单组分热固化环氧胶粘剂，用于BGA、FLIPCHIP、CSP或POP底部填充制程。它能形成一致和无缺陷的底部填充层，通过消除由焊接材料引起的应力，提高元器件的可靠性和机械性能。此类材料能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。此类材料可以对极细间距的部件进行快速填充，具有快速固化能力，拥有较长的工作寿命、使用寿命以及返修性能。返修性允许清除底部填充胶水以便对电路板再度加以利用，从而节省了成本。

倒装芯片组装要求对焊接焊缝进行应力消除，以便延长热力老化和循环寿命。BGA、CSP、POP组装需要使用底部填充胶，以提高元件在弯折、振动或跌落试验时的机械完整性。韩国元化学底部填充胶固化后具有卓越的应力荷载消减能力。CTE、弹性模量及Tg温度的匹配，可有效抵减外力以提高元件的可靠性。另外针对不同芯片焊点分布的特性设计了不同流动及固化特性的产品以匹配多种组装要求。另外特殊助剂的加入可有效减少异形芯片的空洞形成，并兼容更多的其它助焊材料及基材。

产品 Model	描述 Description	粘度 Pa.s	固化条件 Curing Time	Tg (°C)	CTE (ppm/°C)	储存条件 Storage
WE-1007	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA、CSP之底部填充制程</li> <li>在PCB厚板及元件贴装上表现尤佳</li> <li>与常规焊锡膏助焊剂有良好兼容性</li> </ul>	3 ~ 6	20m@120°C 5m@150°C	66	72—186	5°C
WE-1007B	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA、CSP之底部填充制程</li> <li>在PCB厚板及元件贴装上表现尤佳</li> <li>与常规焊锡膏助焊剂有良好兼容性</li> </ul>	3 ~ 6	20m@120°C 5m@150°C	66	72—186	5°C
WE-1007NBLA	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA、CSP之底部填充制程</li> <li>在PCB厚板及元件贴装上表现尤佳</li> <li>符合低卤 ( Halogen Free ) 要求</li> </ul>	3 ~ 5	20m@120°C 5m@150°C	63	84—203	5°C
WE-3008Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA/CSP/POP底部填充制程</li> <li>在PCB薄板软板元件贴装上表现尤佳</li> <li>与常规焊锡膏助焊剂有良好兼容性</li> </ul>	1 ~ 2	20m@120°C 5m@150°C	8	110—215	5°C
WE-3008	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA/CSP/POP底部填充制程</li> <li>在PCB薄板软板元件贴装上表现尤佳</li> <li>符合欧盟低卤 ( HF)及6P环保要求</li> </ul>	1 ~ 2	20m@120°C 5m@150°C	8	110—215	5°C
WE-3008S1	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA/CSP/POP底部填充制程</li> <li>在PCB薄板软板元件贴装上表现尤佳</li> <li>与常规焊锡膏助焊剂有良好兼容性</li> </ul>	2 ~ 3	20m@120°C 5m@150°C	8	110—215	5°C
WE-1100	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于FLIP CHIP元件底部填充制程</li> <li>高玻璃转化温度,可承受高温冲击</li> <li>属于不可返修型产品,可用于保密</li> </ul>	5 ~ 6	20m@150°C	140	100—200	5°C
WE-1105	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于BGA/CSP/POP底部填充制程</li> <li>在PCB薄板软板元件贴装上表现尤佳</li> <li>属于不可返修型产品,可用于保密</li> </ul>	3 ~ 4	10m@150°C	135	125—235	5°C
WE-1201	<ul style="list-style-type: none"> <li>专门设计用于FBGA底部填充制程</li> <li>较高填料含量, 极低的固化收缩率</li> <li>属于不可返修型产品,可用于保密</li> </ul>	5 ~ 6	60m@160°C	150	30—120	5°C

注：由于测试方法及测试设备等差异，以上数据为典型值或者范围，仅供参考，详细参数请参阅最新版本TDS资料及技术人员提供的建议。



## 韩国元化学底部填充胶水

### WE-1007

- |       |   |   |                           |
|-------|---|---|---------------------------|
| 流动性：  | <input checked="" type="radio"/> 高(有预热)   | <input checked="" type="radio"/> 中(无预热)   | <input type="radio"/> 低   |
| 固化速度： | <input checked="" type="radio"/> 快(150°C) | <input checked="" type="radio"/> 中(120°C) | <input type="radio"/> 慢   |
| 返修性：  | <input type="radio"/> 易返修                 | <input checked="" type="radio"/> 可返修      | <input type="radio"/> 难返修 |
| 应用点：  | <input checked="" type="radio"/> BGA      | <input type="radio"/> CSP                 | <input type="radio"/> POP |

典型客户：



环保认证：



相关资料：



详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取

### WE-1007NBLA

- |       |   |   |                           |
|-------|---|---|---------------------------|
| 流动性：  | <input checked="" type="radio"/> 高(有预热)   | <input checked="" type="radio"/> 中(无预热)   | <input type="radio"/> 低   |
| 固化速度： | <input checked="" type="radio"/> 快(150°C) | <input checked="" type="radio"/> 中(120°C) | <input type="radio"/> 慢   |
| 返修性：  | <input checked="" type="radio"/> 易返修      | <input type="radio"/> 可返修                 | <input type="radio"/> 难返修 |
| 应用点：  | <input checked="" type="radio"/> BGA      | <input checked="" type="radio"/> CSP      | <input type="radio"/> POP |

典型客户：



环保认证：



相关资料：



详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取



# 韩国元化学底部填充胶水

## WE-3008

- |       |   |   |                                      |
|-------|---|---|--------------------------------------|
| 流动性:  | <input checked="" type="radio"/> 高        | <input type="radio"/> 中                   | <input type="radio"/> 低              |
| 固化速度: | <input checked="" type="radio"/> 快(150°C) | <input checked="" type="radio"/> 中(120°C) | <input type="radio"/> 慢              |
| 返修性:  | <input type="radio"/> 易返修                 | <input checked="" type="radio"/> 可返修      | <input type="radio"/> 难返修            |
| 应用点:  | <input checked="" type="radio"/> BGA      | <input checked="" type="radio"/> CSP      | <input checked="" type="radio"/> POP |

典型客户:



环保认证:



相关资料:



详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取

## 开发中



新品

型号	特性
WE-3008S	快速固化类型
WE-3008H	助焊功能类型
WE-3008F	底填薄膜类型

定制客户:



环保设计:



相关资料:

暂时只提供实验室数据

详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取

## Won Chemical Underfill Resins

### WE-1007

- |                 |  |   |                              |
|-----------------|--|---|------------------------------|
| Fluidity:       | <input checked="" type="radio"/> High[Preheat] | <input checked="" type="radio"/> Medium[No-Preheat] | <input type="radio"/> Normal |
| Curing Speed:   | <input checked="" type="radio"/> Faster[150°C] | <input checked="" type="radio"/> Medium [120°C]     | <input type="radio"/> Normal |
| Rework Ability: | <input type="radio"/> Easy                     | <input checked="" type="radio"/> Normal             | <input type="radio"/> Hard   |
| Application:    | <input checked="" type="radio"/> BGA           | <input type="radio"/> CSP                           | <input type="radio"/> POP    |

Users:



iriver

Environmental:



Data Sheets:

TDS

MSDS

SGS



Please visit the hyperlinks of data sheets for details, or contact Sales Representative.

### WE-1007NBLA

- |                 |  |   |                              |
|-----------------|--|---|------------------------------|
| Fluidity:       | <input checked="" type="radio"/> High[Preheat] | <input checked="" type="radio"/> Medium[No-Preheat] | <input type="radio"/> Normal |
| Curing Speed:   | <input checked="" type="radio"/> Faster[150°C] | <input checked="" type="radio"/> Medium [120°C]     | <input type="radio"/> Normal |
| Rework Ability: | <input checked="" type="radio"/> Easy          | <input type="radio"/> Normal                        | <input type="radio"/> Hard   |
| Application:    | <input checked="" type="radio"/> BGA           | <input checked="" type="radio"/> CSP                | <input type="radio"/> POP    |

Users:



iriver

Environmental:



Data Sheets:

TDS

MSDS

SGS



Please visit the hyperlinks of data sheets for details, or contact Sales Representative.

## Won Chemical Underfill Resins

### WE-3008

Fluidity:	<input checked="" type="radio"/> High	<input type="radio"/> Medium	<input type="radio"/> Normal
Curing Speed:	<input checked="" type="radio"/> Faster(150°C)	<input checked="" type="radio"/> Medium (120°C)	<input type="radio"/> Normal
Rework Ability:	<input type="radio"/> Easy	<input checked="" type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Hard
Application:	<input checked="" type="radio"/> BGA	<input checked="" type="radio"/> CSP	<input checked="" type="radio"/> POP

Users:



iriver

Environmental:



Data Sheets:



Please visit the hyperlinks of data sheets for details, or contact Sales Representative.

### Under Development



New  
Underfill  
Products

GRADE  
WE-3008S  
WE-3008H  
WE-3008F

FEATURE  
Fast cure type  
Fluxing type  
UnderFilm type

Customize For:



Environmental:



Data Sheets:

Only Laboratory Data Available

Please visit the hyperlinks of data sheets for details, or contact Sales Representative.



## 한국 원케미컬 언더필수지

### WE-1007

유동성:	● 높음 [예열]	● 중간[무예열]	○ 낮음
경화속도:	● 빠름[150℃]	● 중간[120℃]	○ 늦음
리패어 난이도:	○ 쉬움	● 가능	○ 어려움
적용점:	● BGA	○ CSP	○ POP

대표적 사용업체:



환경보호인증:



관련 자료:



기술 관련 내용은 "관련 자료"를 클릭하여 확인해주시고,기타 궁금하신 사항은 에이전트에 문의해 주시기 바랍니다.

### WE-1007NBLA



유동성:	● 높음 [예열]	● 중간[무예열]	○ 낮음
경화속도:	● 빠름[150℃]	● 중간[120℃]	○ 늦음
리패어 난이도:	● 쉬움	○ 가능	○ 어려움
적용점:	● BGA	● CSP	○ POP

대표적 사용업체:



환경보호인증:



관련 자료:



기술 관련 내용은 "관련 자료"를 클릭하여 확인해주시고,기타 궁금하신 사항은 에이전트에 문의해 주시기 바랍니다.

## 한국 원케미컬 언더필수지

### WE-3008

- |          |            |            |       |
|----------|------------|------------|-------|
| 유동성:     | ● 높음 (예열)  | ○ 중간(무예열)  | ○ 낮음  |
| 경화속도:    | ● 빠름[150℃] | ● 중간[120℃] | ○ 늦음  |
| 리퍼어 난이도: | ○ 쉬움       | ● 가능       | ○ 어려움 |
| 적용점:     | ● BGA      | ● CSP      | ● POP |

대표적 사용업체:



환경보호인증:



관련 자료:



기술 관련 내용은 "관련 자료"를 클릭하여 확인해주시고,기타 궁금하신 사항은 에이전트에 문의해 주시기 바랍니다.

### 신제품(연구개발중)



신  
상  
품

모름  
WE-3008S  
WE-3008H  
WE-3008F

특성

Fast Curing  
Flux  
Underfilm

커스터마이즈 :



환경보호 :



관련 자료 : 일시적으로는 테스트 데이터만 참고로 드립니다.

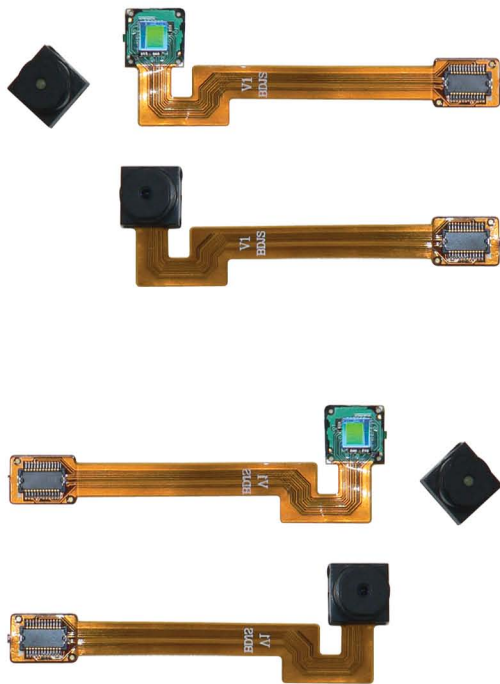
기술 관련 내용은 "관련 자료"를 클릭하여 확인해주시고,기타 궁금하신 사항은 에이전트에 문의해 주시기 바랍니다.

## 韩国元化学CCD/CMOS低温粘接胶

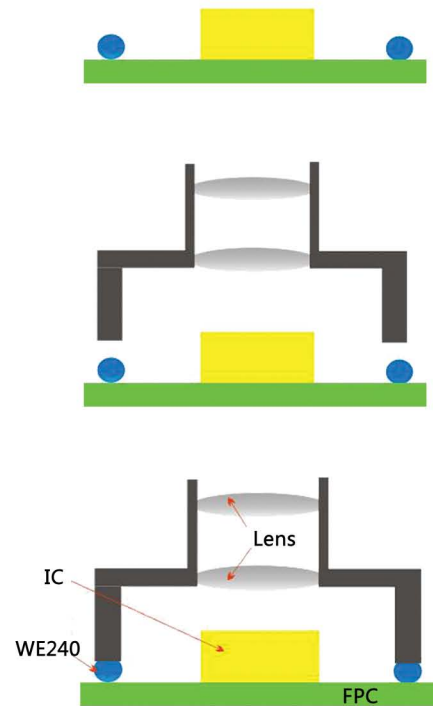
元化学WE-240低温粘接胶系单组份、低温热固化改良型环氧树脂胶粘剂。该产品适用于低温固化，并能在极短的时间内在各种材料之间形成最佳粘接力。产品工作性能优良，具有较高的保管稳定性，适用于记忆卡、CCD/CMOS 镜头与FPC底座等装置的粘接。特别适用于需要低温固化的热敏感元件。韩国元化学（WON CHEMICAL）的产品已经在韩国本土三星等公司得到大批量应用。

Won Chemical WE-240 low temperature curing adhesives are one part, low temperature heat curable epoxy. This product is designed to cure at low temperature and gives excellent adhesion on a wide range of materials in considerably short time. Typical applications include Memory cards、CCD/CMOS Assemblies. Particularly suited heat sensitive components which require low temperature cure.WE-240 has been used widely in SAMSUNG factory in Korea locally.

粘接实物图



粘接示意图



Item	Viscosity/ pa.s	Cure Condition	Colour	Strength	Storage	Package
WE-240	40~80	80°C @20min 120°C @5min	Black	> 2.5kg	Sealed-20°C/6m	10ml/30ml
WE-240R	20~60	60°C @25-35min 70°C @ 15-25min 80°C @ 5-10min	Black	> 2.5kg	Sealed-20°C/6m	10ml/30ml

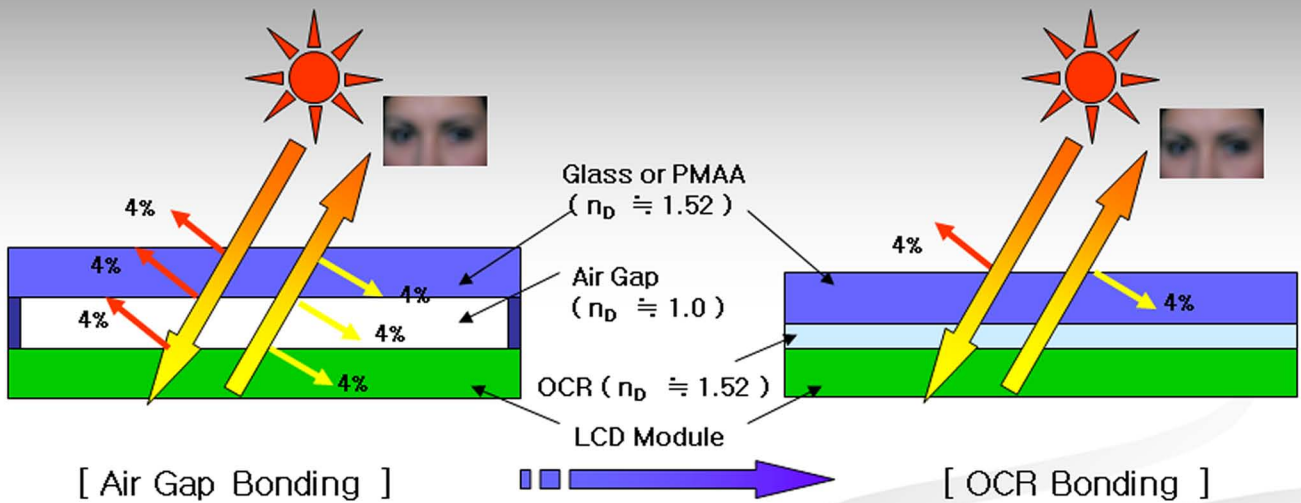


# 韩国元化学OCR光学透明胶 ( Optical Clear Resin)

韩国元化学光学透明树脂(OCR)是设计用于透明光学元件粘结的特种粘结剂，光学透明树脂可填充面板与透明保护层及液晶模组之间的空隙，以提高显示器的对比，与传统采用空气间隙的方法相比，此光学树脂可抑制外部光照与背光等导致的光散射情况。UV照射迅速反应成型的光学透明树脂具有与玻璃相近的折射率和透光率、耐黄变、柔软可承受多种不同基材的膨胀收缩率，以致于可抵挡贴合同时高低温变化产生的问题。此产品适用于触控屏、大尺寸玻璃基板或其它软硬板之间的贴合与组装。

## 产品特性

- ◇固化方式：紫外光UV固化，点面光源结合；
- ◇化学体系：无酸胶体，具有与ITO相容特性；
- ◇易使用性：可选择点胶或其它对应涂布方式；
- ◇可修复性：未完全固化前具有可重工的特性；
- ◇光学特性：高光学穿透特性及匹配的折光率；
- ◇其他特性：低硬度、低收缩、低雾度(Haze)。



	OCR-050K	OCR-1050K	OCR-2050D	OCR-2150D
Viscosity ( cps )	≈ 1,500	≈ 1,500	≈ 1,500	≈ 1,500
Cure Energy ( mJ/cm <sup>2</sup> )	> 3,000	> 3,000	> 3,000	> 3,000
Hardness	Shore-A: 5	Shore-A: 7	Shore-00: 50	Shore-00: 50
Refractive Index	1.50	1.50	1.50	1.50
Elongation ( % )	> 300	> 300	> 300	> 400
Transmittance ( % )	> 98	> 98	> 98	> 98
Shrinkage ( % )	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Yellowing on Aging	Low	Low	Low	Low
Haze ( % )	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3

# 韩国元化学OCR光学透明胶 ( Optical Clear Resin)

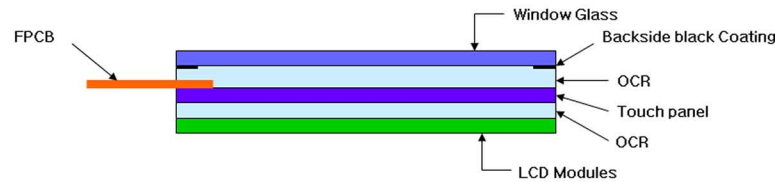
	OCR-3250D	OCR-3350D	OCR-060K	OCR-060D
Viscosity ( cps )	≒1,500	≒1,500	≒3,000	≒3,000
Cure Energy ( mJ/cm <sup>2</sup> )	> 3,000	> 3,000	> 3,000	> 3,000
Hardness	Shore-00: 60	Shore-00 : 55	Shore-A : 5	Shore-00 : 65
Refractive Index	1.50	1.50	1.50	1.50
Elongation ( % )	> 300	> 400	> 300	> 400
Transmittance ( % )	> 98	> 98	> 98	> 98
Shrinkage ( % )	< 1.0	< 1.0	< 1.0	< 1.0
Yellowing on Aging	Low	Low	Low	Low
Haze ( % )	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3

1) Tempered Glass / Touch panel Bonding



- ◆ Thinner sizing by eliminating air gap
- ◆ Luminescence & Contrast increase by refractive index control
- ◆ Visibility increase in outside

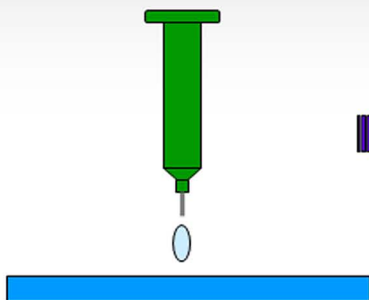
2) Tempered Glass / Touch panel & LCD Module Bonding



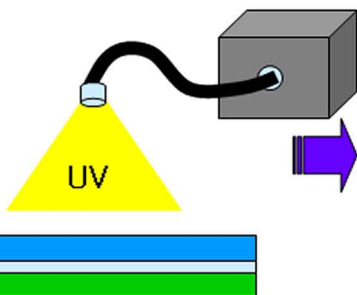
- ◆ Luminescence & Contrast increase by refractive index control

## Bonding Process Flow

1. Dispensing OCR to one Substrate



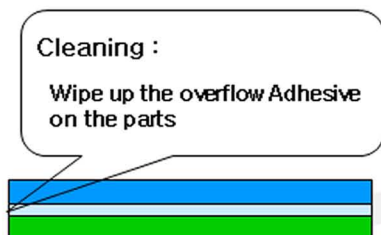
4. Pre-Cure



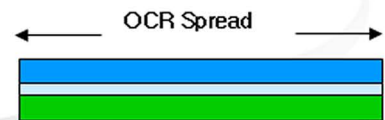
2. Bonding two parts



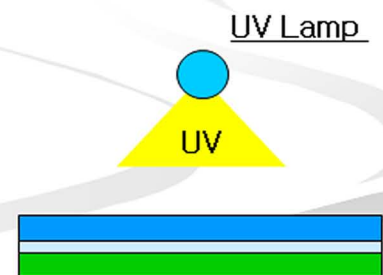
5. Inspection & Cleaning



3. Spread & Alignment



6. Full Cure



# 韩国元化学OCR光学透明胶 ( Optical Clear Resin)

## OCR-3350D/H

- 光学特性： ● 折射率 >1.5    ● 透光率>95%    ● 雾度<0.3%  
 固化方式： ● UV固化 (点光源+面光源)    ● 热固化 (60m@80°C)  
 返修性： ● 未固化及点固化后可返修，面固化后不可返修  
 应用点： ● 适用于10英寸以上Window/Touch Panel/LCD Panel贴合

典型客户：



环保认证：



相关资料：



详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取

## OCR-1050K/H



- 光学特性： ● 折射率 >1.5    ● 透光率>95%    ● 雾度<0.3%  
 固化方式： ● UV固化 (点光源+面光源)    ● 热固化 (60m@80°C)  
 返修性： ● 未固化及点固化后可返修，面固化后不可返修  
 应用点： ● 适用于5英寸以下Window/Touch Panel/LCD Panel贴合

典型客户：



环保认证：



相关资料：



详细技术参数请点击“相关资料”对应超链接在线查看，或者联络代理商销售代表索取

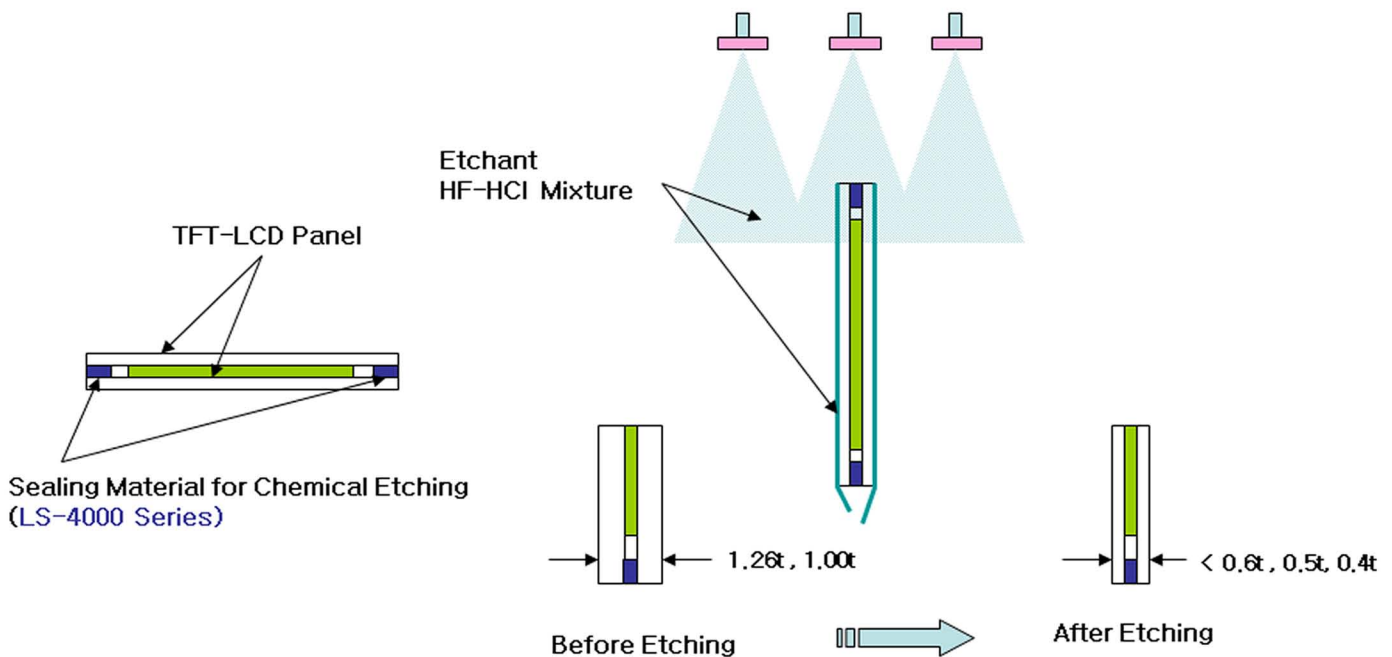


# 韩国元化学TFT-LCD玻璃薄化密封胶

TFT-LCD玻璃薄化密封胶是一种紫外线固化的粘接材料，主要用于液晶面板行业玻璃薄化工艺中TFT面板和彩色滤光片面板间的粘接和密封。该产品具有优异的耐强酸性（HF-HCl），与玻璃有着非常优秀的粘接能力，并且流动均匀可形成一致的粘接厚度。另外产品在薄化工艺前后有明显的区别，易于管理和区分。韩国元化学（WON CHEMICAL）的产品已经在韩国本土LG等公司得到大批量应用。

TFT-LCD Panel is slimed by Chemical Etching after TFT-Panel & Color Filter panel are bonded with UV adhesive

Application : Note PC, Net PC, Cellular Phone, Navigation or special TV  
Touch Screen Panel of Capacitive type



## ■ Demand Characteristics

- Anti-resistance for HF-HCl
- Uniform Penetration
- Good Adhesion on Glass
- Distinguish between worked and not

## ■ Products

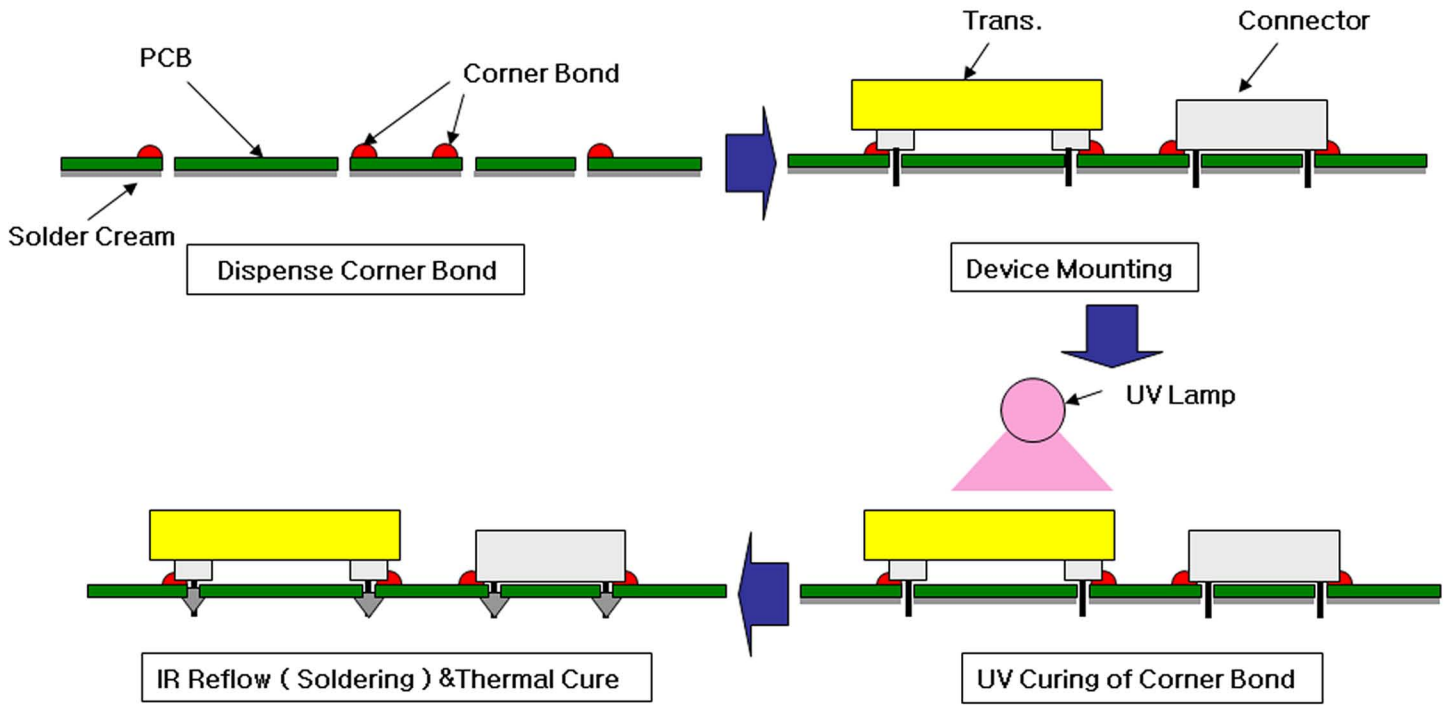
	LS-4003	LS-4004V5	LS-4004V8	LS-4004V40
Color	Blue	Blue	Blue	Blue
Viscosity,cps	3500±200	500±100	800±100	4000±200
Cure,mJ/cm <sup>2</sup>	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000
Hardness	-	-	-	-
Customer	LG			

## 韩国元化学电子装配补强胶

韩国元化学电子装配补强胶是一种紫外线固化的粘接材料，主要用于SMT表面组装行业中SMD元器件的四角邦定补强（Corner Bonding），此类产品已在韩国本土LG公司等到批量应用；另外针对微型耳机组装中的固定补强需求，元化学开发出专用补强型号，产品在SONY公司也得到了批量的应用。

### Corner Bond for SMD (Surface Mounting Device)

Lots of electronic & Electric parts are fixed before soldering for SMD



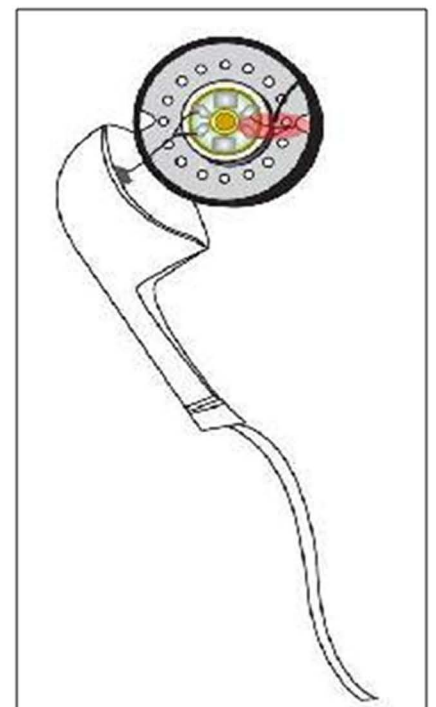
### Reinforcing material for Earphone Wire

Wire of Earphone is reinforced for preventing break-off

■ Application & Demand Characteristics of reinforcing Material for Earphone wire

- Excellent thermal cycle resistance
- Good adhesion for Metal & other substrate
- Good Humidity resistance

	1-131BT	1-131BT(Blue)
Color	Milky Haze Liquid	Sky blue Haze
Viscosity, cps	18000 ± 1000	15000 ± 1000
Cure, mJ/cm <sup>2</sup>	> 1000	> 1000
Hardness (Shore-D)	60	55
Customer	SONY	



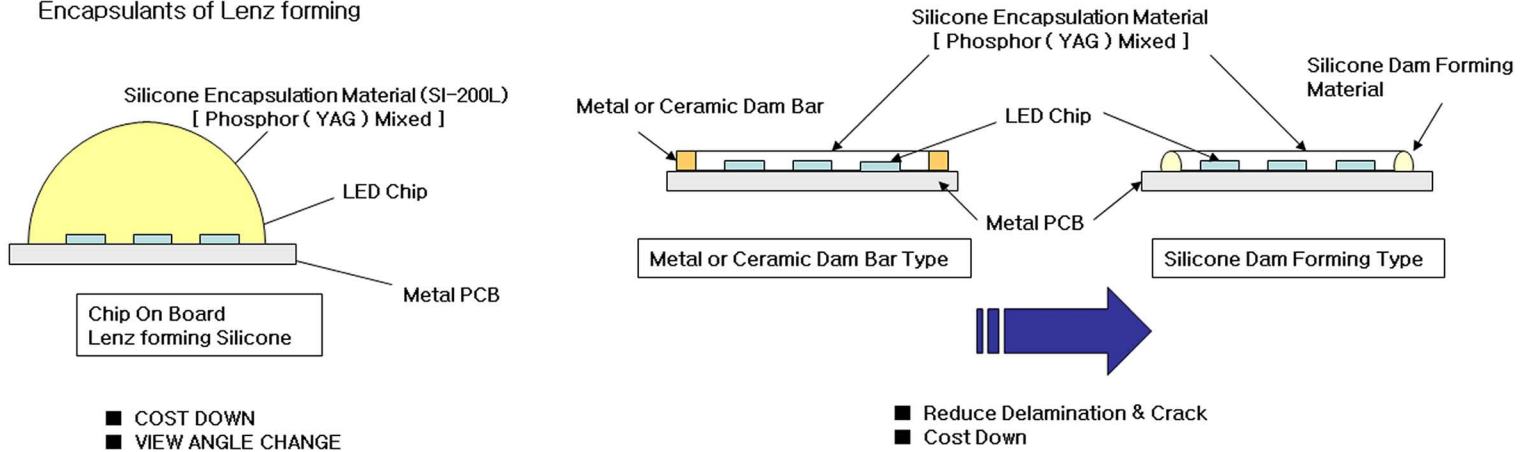
## 韩国元化学高透光LED封装胶

韩国元化学高透光LED封装胶是一种有机硅为主体的双组分产品，主要用于高透光发光二极管的封装，尤其适用于LED LAMP和SMD LED的封装。封装胶可分为围堰型 ( DAM)和填充型 ( ENCAPSULANT)，可用于透镜成型封装或者平面成型封装LED芯片，产品固化后形成良好及一致的表面，有效保护LED芯片免受外界的机械压力、湿热冲击、灰尘及其它污染物的侵害。

### 产品特性

卓越的光学特性，高亮度及高透光率及耐黄变；合适的粘度及触变特性可有效避免荧光粉沉降；成型后低硬度高粘接力可有效减少分层和裂纹；二甲基硅烷体系可有效提高产品耐热和耐晒性；高可靠产品，有效降低长时间工作后的光衰减；围堰胶和填充胶配合可有效控制芯片封装高度。

Encapsulants of Lenz forming



	SI-110	SI-150	SI-170	SI-100 DF	SI-200L
Characteristics	Low viscosity Good Adhesion	Good Adhesion	Good Adhesion	White Color High Thixotropy	Thixotropy
Mix Viscosity (25°C, cps)	1,000	5,000	7,000	110,000 (1-part liquid)	20,000
Thixotropic Index	-	-	-	6.2	4.0
Transmittance (450 nm)	96	97	97	-	92
Hardness (Shore-A)	53	50	50	60	56
Cure Time(150°C, hrs)	2	2	2	2	2
Refractive Index	1.41	1.41	1.41	-	1.41
Application	Filling of LED	Filling of LED	Filling of LED	Dam forming	Lenz forming COB type
Customer	LUMI MICRO KOREA				UNDER DEVELOPMENT



## 深圳市力邦泰科技有限公司

### 关于力邦泰

深圳市力邦泰科技有限公司是一家专业的电子胶水方案提供商，提供专业的电子胶水应用技术顾问服务。力邦泰科技有限公司一直致力于不断超越、不断追求的创新与产品方案，以满足具有成本意识和品质意识的客户的高标准需要。我们的专业人员将为您提供高品质的产品，优质的服务和专业的技术咨询。我们不提倡纯粹的产品取代及以牺牲产品可靠性为前提的产品成本下降，我们更愿意配合客户建立更科学合理的产品综合性能评估方案。

经过七年的不懈努力，力邦泰科技已经为世界级的电子厂商及国内领先的电子厂商提供产品、服务及解决方案，并成为以下诸多公司之合格及优秀供应商。



.....

专业 · 专注 · 专心 Specialty · F engrossment · Concentration

力邦泰公司秉承对客户，对员工以及对环境负责之理念。为此我们承诺：

- 技术与销售相结合为客户提供迅速而贴心的服务；
- 对新产品和已销售的优质产品进行跟踪研究以确认产品质量的提高；
- 公平的员工待遇有助于更多的意见及建议的提出；
- 尽全力保障雇员、大众、环境之安全及公司财产和声誉。

深圳市力邦泰科技有限公司通过致力于产品的可靠性, 各项标准的遵守以及准确的物流来保证胶水的优质。在技术需求多样的今天，我们致力于使我们与众不同，成为一个在国内和国际领域可靠且负责任的公司。